

**BASSE-NORMANDIE**

**La jeune société caennaise lance un important programme de recherche et développement. Le projet d'innovation collaborative à finalité industrielle devrait permettre de renforcer la filière microélectronique.**

# Electronique : Ipdia va piloter un projet de R&D de 53 millions d'euros

DE NOTRE CORRESPONDANT  
À CAEN.

Née en avril dernier d'un accord entre un consortium d'actionnaires et NXP (« Les Echos » du 22 avril 2009), Ipdia (15 millions d'euros de chiffre d'affaires et 100 emplois), fabricant de composants électroniques implanté à Caen, va coordonner un important programme national de R&D (recherche et développement) mêlant acteurs publics et privés.

D'un montant de 53 millions d'euros et baptisé « Projet de réalisation et d'innovation industrielle de microsystèmes hétérogènes » (PRIIM), le programme va définir de nouveaux besoins applicatifs pour des marchés en très forte croissance tels que les appareils médicaux implantables (sti-

mulateurs, défibrillateurs, détecteurs de mouvement), les cartes à puce multimédia et les systèmes embarqués complexes.

## Ultra-miniaturisation

*« Ce projet va nous permettre à la fois de faire du développement de technologies en amont mais aussi d'assurer la définition de produits et la réalisation de prototypes. Il s'agit, avec ce programme, de maintenir l'avance que nous avons sur la concurrence »,* explique Franck Murray, PDG d'Ipdia.

Les différents acteurs du projet vont donc travailler sur des nouveaux matériaux, des structures et des procédés innovants pour réaliser des composants passifs sur silicium de très haute performance et résistant à des environnements sévères ainsi que sur des

technologies d'assemblage innovantes permettant l'ultra-miniaturisation des futurs produits.

Financé par le programme Innovation stratégique industrielle (ISI) d'Oséo à hauteur de 21,2 millions d'euros sur quatre ans, le projet PRIIM doit permettre à la fois de renforcer la filière industrielle microélectronique européenne et nationale et d'offrir des débouchés industriels supplémentaires aux nombreuses innovations présentes et futures issues des meilleurs laboratoires publics.

Le projet réunit donc des partenaires industriels (3D Plus, Ela Medical, Movea, Kalray et Gemalto) ainsi que des centres de recherche (CEA LETI, CNRS LAAS et CNRS CRISMAT). « *Ce type de projet [...] est très promet-*

*teur car, en cas de succès, il vise à commercialiser les produits de rupture technologique et ne pourrait se réaliser sans incitation publique »,* indique Oséo.

D'une durée de quatre ans, le programme a également été labellisé par deux pôles de compétitivité, Minalogic (à Grenoble) et Transactions électroniques sécurisées (à Caen). « *Ipdia et ses partenaires créeront des nouveaux composants passifs intégrés et des technologies d'assemblage pour des nouveaux produits à forte valeur ajoutée. En complément, PRIIM permettra de mettre en place une véritable offre industrielle et indépendante de fabrication de composants passifs intégrés et de packaging avancés »,* déclare Franck Murray.

PHILIPPE LEGUELTEL